



RE933

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für 10 verschiedene TSSOP's
- Pitch: 0,65 mm & 0,50 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Größe 58,90 x 120,10 mm

Modul-Nr.	Pitch	mil	Pin	Größe (mm)
RE933-01	0,650 mm	22,5	8	4,400 (173 mil)
RE933-02	0,650 mm	22,5	14	4,400 (173 mil)
RE933-03	0,650 mm	22,5	16	4,400 (173 mil)
RE933-04	0,650 mm	22,5	20	4,400 (173 mil)
RE933-05	0,650 mm	22,5	24	4,400 (173 mil)
RE933-06	0,650 mm	22,5	28	4,400 (173 mil)
RE933-07	0,650 mm	22,5	32	4,400 (173 mil)
RE933-08	0,500 mm	19,6	38	6,100 (240 mil)
RE933-09	0,500 mm	19,6	48	6,100 (240 mil)
RE933-10	0,500 mm	19,6	56	6,100 (240 mil)